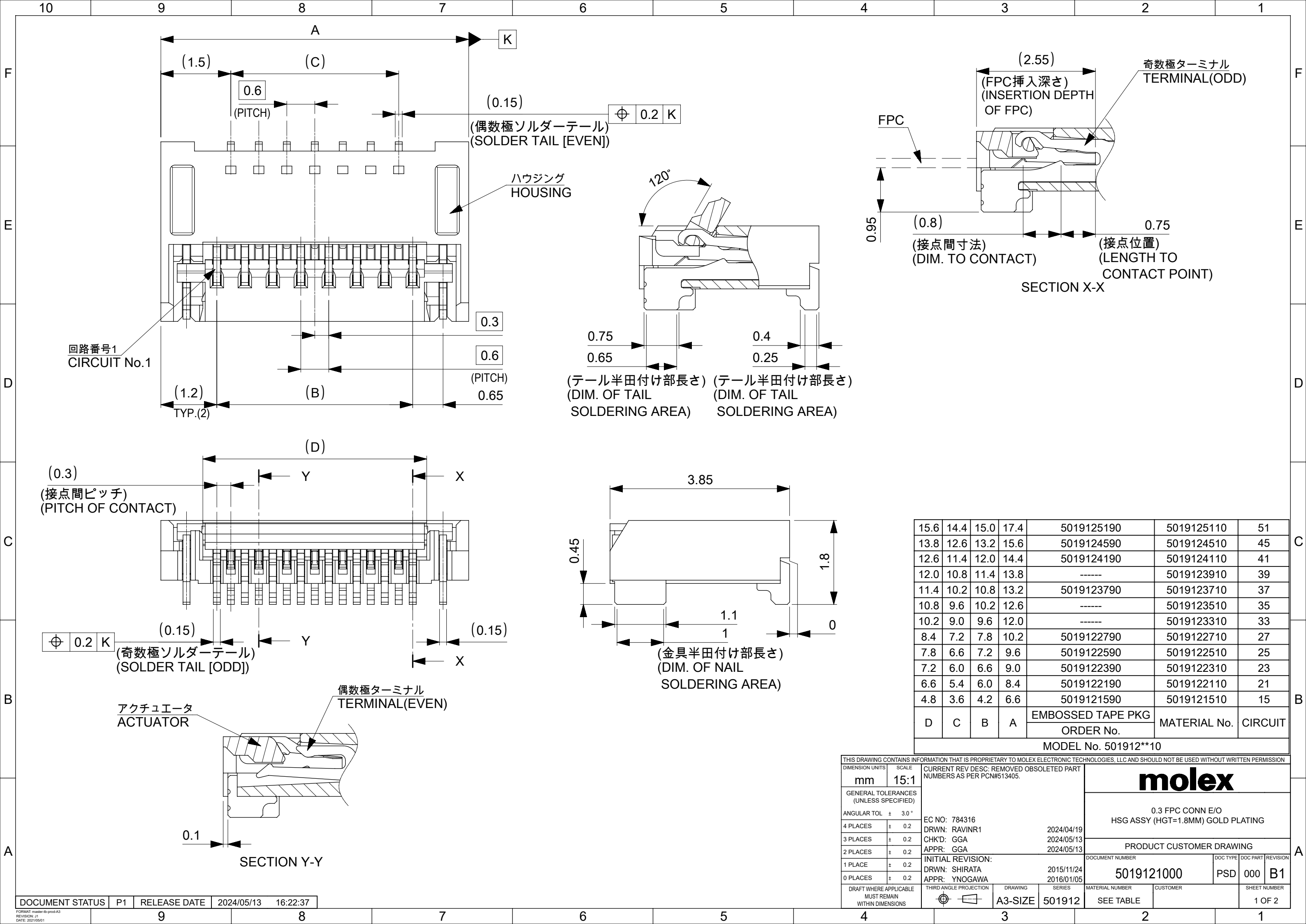
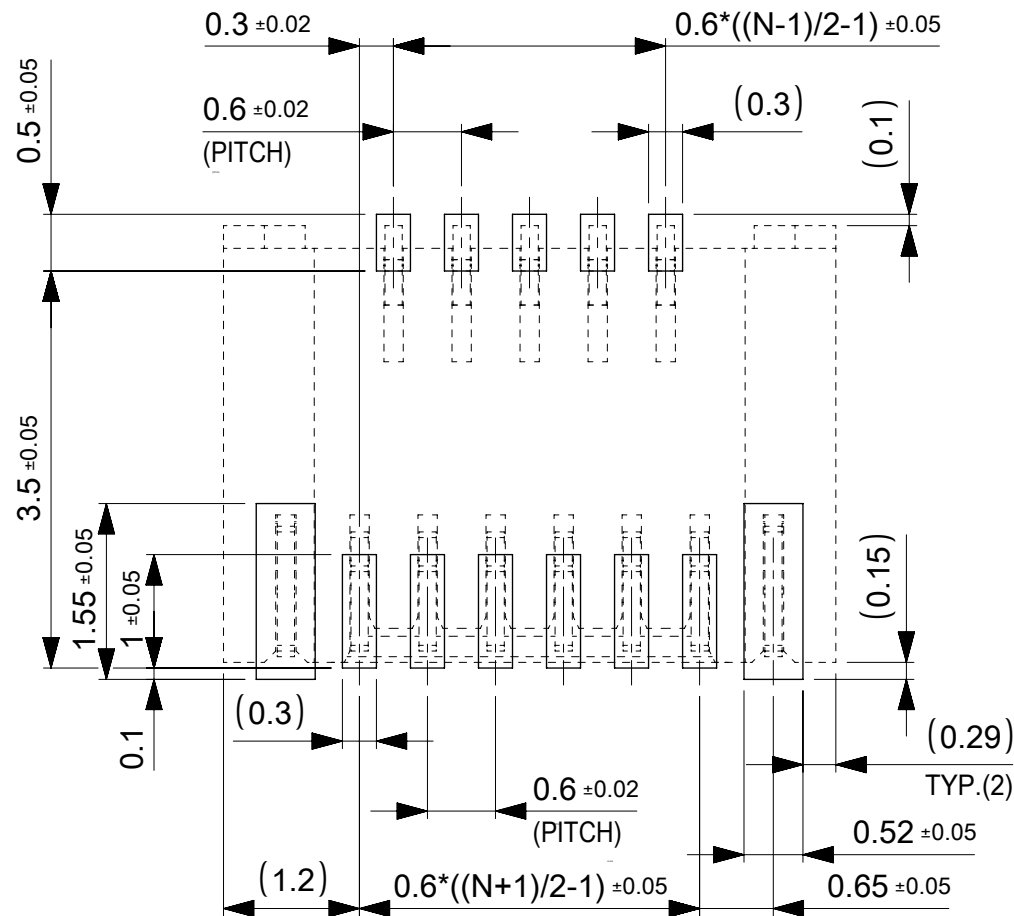






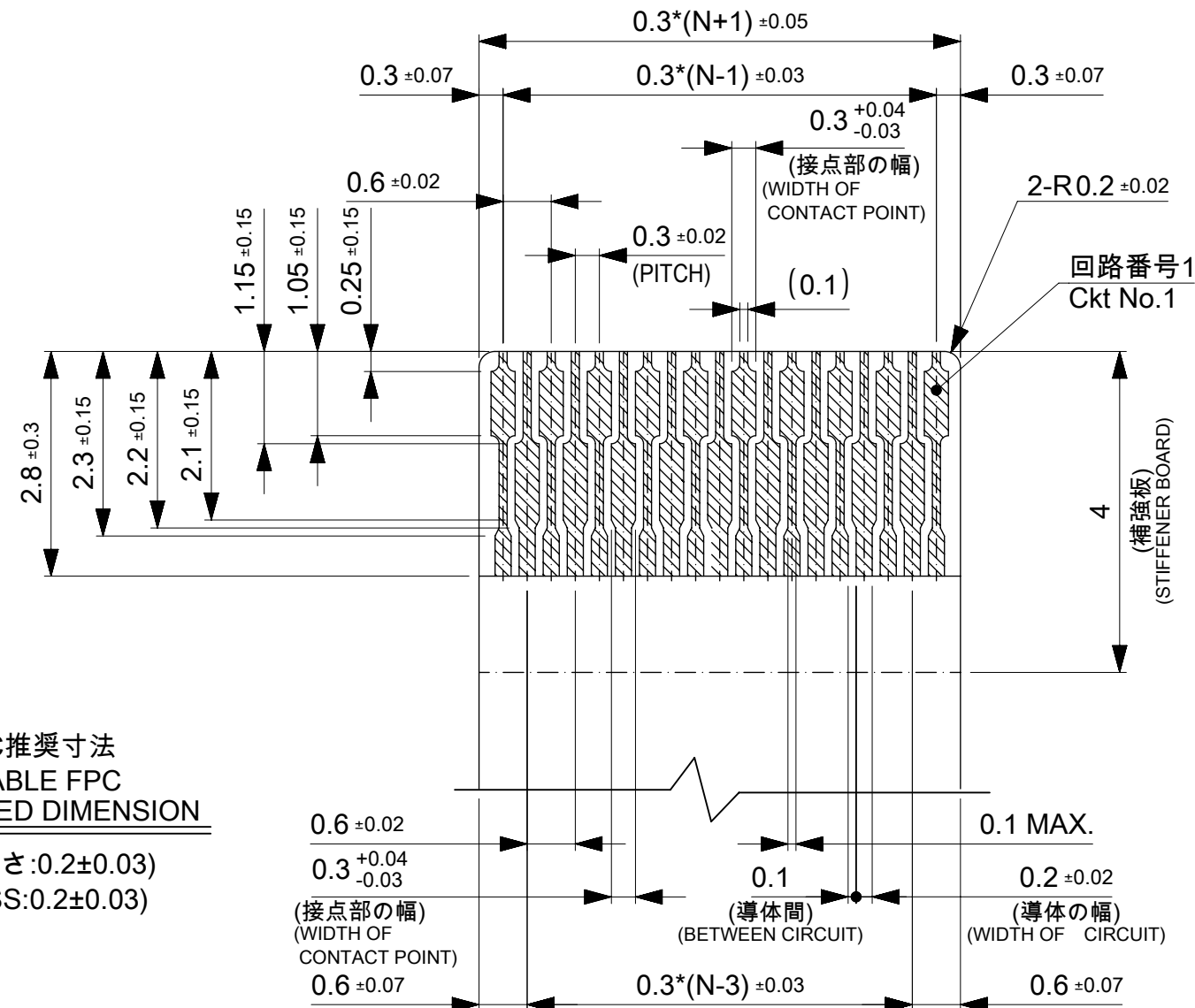
参考基板レイアウト図
(マウント面)
(MOUNTING SIDE)

注記 NOTES

1. 使用材料 MATERIAL
- | | | |
|--------------|---|---------------|
| ハウジング | :耐熱性樹脂 | ガラス充填 UL94V-0 |
| HOUSING | :HEAT RESISTANCE POLYMER(GLASS FILLED) | UL94V-0 |
| アクチュエータ | :耐熱性樹脂 | ガラス充填 UL94V-0 |
| ACTUATOR | :HEAT RESISTANCE POLYMER(GLASS FILLED) | UL94V-0 |
| ターミナル | :銅合金(t=0.15)、ニッケル下地金メッキ | |
| TERMINAL | :COPPER ALLOY(t=0.15),GOLD OVER NICKEL PLATING. | |
| 金具 | :銅合金(t=0.15)、ニッケル下地スズメッキ | |
| FITTING NAIL | :COPPER ALLOY(t=0.15),TIN OVER NICKEL PLATING. | |
- ハウジングに黒点がある場合がありますが、問題はありません。
2. ソルダータール半田付け面、及び金具半田付け面の平坦度 : 0.1mm MAXIMUM.
COPLANARITY OF SOLDER TAILS AND FITTING NAILS TO BE 0.1mm MAXIMUM.
3. ELV AND RoHS COMPLIANT.

適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ:0.2±0.03)
(THICKNESS:0.2±0.03)



FPCについて:

打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
導体部については軟銅箔35マイクロメートルまたは50マイクロメートルを推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨します。

ABOUT FPC

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.

RECOMMENDED CONDUCTOR SPEC :

THICKNESS OF SOFT COPPER FOIL : 35 MICROMETER OR 50 MICROMETER.

RECOMMENDED MATERIAL :

STIFFENER FILM : POLYIMIDE

BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									
DIMENSION UNITS		SCALE	CURRENT REV DESC: REMOVED OBSOLETE PART NUMBERS AS PER PCN#513405.						
mm		15:1							
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)									
ANGULAR TOL	±	3.0 °							
4 PLACES	±	0.2							
3 PLACES	±	0.2							
2 PLACES	±	0.2							
1 PLACE	±	0.2							
0 PLACES	±	0.2							
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING	SERIES	MATERIAL NUMBER	CUSTOMER		SHEET NUMBER
				A3-SIZE	501912	SEE TABLE			2 OF 2

DOCUMENT STATUS			P1	RELEASE DATE	2024/05/13	16:22:37
-----------------	--	--	----	--------------	------------	----------